

北京国化新材料技术研究院有限公司文件

关于召开“2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会”的预通知

各有关单位：

纳米二氧化硅是应用体量最大、下游领域最宽的纳米材料之一。近年来，伴随半导体先进制程的持续演进、新能源电池技术的迭代突破以及高端涂料与胶黏剂的应用升级，纳米二氧化硅在纯度、粒径可控性、表面功能化及分散稳定性等方面面临更高要求。绿色制备工艺的普及、复合改性技术的创新、以及在新兴领域的精准应用，正成为产业升级的核心驱动力。

为进一步推动二氧化硅行业技术创新与产业升级，我院拟定于2026年10月27-29日在深圳举办“2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会”。本会将以“精准纳米，智创未来”为主题，设立“气相二氧化硅、沉淀二氧化硅、高端硅溶胶/CMP 材料”三大热门分论坛。报名本会，可免费参加“2026 华南硅业大会及展览会”的5个配套会议，具体通知如下：

一、组织机构

支持单位：中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会、硅产业绿色发展联盟 SAGSI、中关村光伏产业联盟 ZPVA、云南省硅工业工

程研究中心

主办单位：北京国化新材料技术研究院

承办单位：ACMI 硅基新材料研究所

支持媒体：有机硅、气凝胶产业、ACMI 硅基新材料、ACMI 光伏新材料、国化新材料研究院、化工新材料、硅产业绿色发展联盟官网

二、暂定日程

(一) 时间地点：

会议时间：2026 年 10 月 27-29 日

会议地点：广东深圳

会议场地：深圳登喜路国际大酒店

场地地址：深圳市宝安区西乡街道宝田一路 12 号

(二) 会议议程：

10 月 27 日全天 参展、安排班车	第六届深圳氟硅材料高端应用展览会 2026 深圳国际薄膜与胶带展 时间地点：2026 年 10 月 27-29 日 深圳会展中心
10 月 27 日全天	注册、签到
10 月 28 日上午	大会主论坛
10 月 28 日下午	主题一：气相二氧化硅
10 月 29 日上午	主题二：沉淀二氧化硅
10 月 29 日下午	主题三：高端硅溶胶/CMP 材料

报名本会 免费参加同期 展会、会议	2026 华南硅业大会及展览会： 1、2026 硅橡胶技术创新与应用发展峰会； 2、2026 硅树脂技术创新与应用交流会； 3、2026 先进硅基陶瓷技术与应用交流会； 4、2026 第四届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛
-------------------------	---

三、收费标准

(1) 参会费用

日期	9月15日	10月15日	10月15日后
价格	2800元/人	3000元/人	3200元/人

三人及以上团体再优惠 200 元/人。学生半价。费用含会议费、餐饮（中餐和晚餐）及其它杂费。住宿统一安排，费用自理。

(2) 展位费用

展位类型	价格	备注
展板展位	18000元/个	1、展板尺寸 2.2 米（宽）*3 米（高）， 配套一张展桌，两把椅子； 2、赠送参会名额 2 人；

(3) 账户信息

户 名：北京国化新材料技术研究院有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行

账 号：0200 2282 0902 0125 456

汇款请注明“二氧化硅会议”

(4) 商务合作

会议接受赞助发言、展位、手册广告、挂绳、胸卡、易拉宝、客户对接等各类商务合作，详询会务组。

四、联系方式

张 慧 17352637513 zhanghui@acmi.org.cn

唐乃美 18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn

附件 1: 参会回执表

附件 2: 分论坛及暂定议题

北京国化新材料技术研究院有限公司

二〇二六年五月九日



附件 1:

参会回执表

会议名称后打✓	2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会			
企业* (发票抬头)				
经营产品	(限添 3 种, 将录入通讯录中)			
通讯地址*				邮 编
参会代表	姓 名	职 务	手 机	电子邮箱
详细信息*				
参会费用	日期	9 月 15 日前	10 月 15 日前	10 月 15 日后及现场
	价格	2800 元/人	3000 元/人	3200 元/人
	____万__仟__佰__拾__元 ¥: ____元 三人及以上团体再优惠 200 元/人。学生半价。 (含会费、餐饮, 不含住宿, 汇款注明: 硅橡胶会议)			
付款方式	户 名: 北京国化新材料技术研究院有限公司 开 户 行: 中国工商银行股份有限公司北京中航油支行 账 号: 0200 2282 0902 0125 456 汇款请注明“二氧化硅会议”			
住宿信息*	1、深圳登喜路国际大酒店(准五星), 深圳市宝安区宝田一路 12 号, 0755-23008888, 豪华大床 480 元/天(含早), 豪华双床 500 元/天(含早) 2、深圳嘉禧国际酒店, 深圳宝安宝田一路地铁站点, 距会议酒店 60 米, 单间/标间 350 元/天含早 (签到时间 10 月 27 日, 会议时间 10 月 28-29 日) 住宿时间: __月__日至__月__日 共__天, 单间__间, 标间__间, 因会议人数较多, 房间有限, 会务组仅为付费代表提前预留房间, 房费请与酒店直接结算; 留房截止日期 10 月 15 日; 未支付会议费的代表, 住宿请自行安排。			
会务组	张 慧 17352637513 zhanghui@acmi.org.cn 唐乃美 18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn			
提示: *为必填项; 参会单位请把报名表 Email 至会务组(以上一人即可), 以便制作通讯录等资料; 发票种类(打✓): 电子专票____; 电子普票____。 开票资料:				

附件 2：分论坛及暂定议题

开幕式及主论坛

1、嘉宾致辞

主办方及联合会领导致辞

国际相关行业组织代表致辞

大会主要赞助单位代表致辞

2、主旨报告

院士作前沿技术报告

国家产业主管部门及行业协会专家解读政策

全球龙头企业负责人分享产业实践

著名经济专家分析宏观形势与市场前景

3、嘉宾巡展

领导、院士及与会嘉宾巡视展区

主题一：气相二氧化硅

中国气相二氧化硅产业发展现状与未来趋势展望

气相二氧化硅连续化生产工艺优化与智能化升级路径

射频电场辅助原位改性技术在高性能气相二氧化硅制备中的创新应用

复合金属氧化物负载型疏水气相二氧化硅的设计与多功能化研究

有机-无机杂化壳层包覆技术在气相二氧化硅表面改性中的前沿进展

疏水型气相二氧化硅在环氧富锌漆中的高效防沉降与防腐性能突破

气相二氧化硅在新能源电池隔膜涂敷层中的界面调控与应用

气相二氧化硅与碳纳米管/石墨烯复合材料的协同增强机制

气相二氧化硅粉末在聚氨酯密封胶中的流变学调控与抗流挂技术

高比表面积气相二氧化硅在无机保温膏料中的隔热增强机理

气相二氧化硅在打印耗材炭粉中的流动性改善与电荷控制研究

气相二氧化硅生产过程中的三废减排与绿色制造技术路径

气相二氧化硅在新型食品添加剂与药物载体中的前沿探索

亲水/疏水型气相二氧化硅在化妆品配方中的肤感调控与稳定技术

气相二氧化硅在功率型 LED 封装材料中的光学性能与热管理协同优化

航空航天用轻质高温隔热材料中气相二氧化硅的关键作用

气相二氧化硅在动力电池导热结构胶中的补强与流变增效应用

气相二氧化硅在 5G 通信设备散热材料中的导热网络构建技术

气相二氧化硅在 3D 打印光敏树脂中的触变性与打印精度调控研究

气相二氧化硅在可降解塑料中的增强增韧与界面相容性研究

主题二：沉淀二氧化硅

中国沉淀法二氧化硅产能现状、技术进步与市场格局分析

CO₂碳化法在沉淀二氧化硅绿色制造中的应用进展

结构化控制工艺制备开链状分支结构沉淀二氧化硅的补强效率提升研究

复合硅烷偶联剂原位改性制备高分散沉淀二氧化硅的关键技术

低表面羟基浓度沉淀法二氧化硅的制备及其在高温环境中的应用

轮胎用高分散白炭黑的“结构化控制”新工艺与能效平衡艺术

沉淀二氧化硅在绿色轮胎中的应用生物基硅烷偶联剂表面改性沉淀二氧化硅的界面化学与补强机制

高比表面积低吸油值二氧化硅在涂料中的消光性与分散稳定性研究

沉淀白炭黑的形态调控、造粒技术及下游混炼适应性研究

超细沉淀白炭黑取代气相白炭黑在硅橡胶中的应用边界与成本优化

沉淀二氧化硅在锂离子电池隔膜涂层中的热稳定性与电化学兼容性

物理法结晶型纳米二氧化硅在工程塑料中的增强改性应用

食品级沉淀二氧化硅在抗结剂与载体材料中的安全性与性能标准

口腔护理用高磨值沉淀二氧化硅的表面硬度与清洁性能调控技术

沉淀二氧化硅在农药载体中的分散稳定性与缓释性能研究

沉淀二氧化硅在可降解复合材料中的界面增强与生物相容性研究

智能化生产系统在沉淀二氧化硅全流程参数监控与一致性控制中的应用

沉淀二氧化硅的标准化孔结构分析与分散性评价体系建立

沉淀二氧化硅在粉末涂料中的荷电性与流平性协同优化研究

主题三：高端硅溶胶/CMP 材料

全球经济下行背景下二氧化硅基 CMP 浆料的市场机遇与挑战

芯片全局平坦化的“纳米级牙膏”：SiO₂抛光浆料的核心技术与国产化突围

超高纯硅溶胶制备关键技术：金属杂质控制、粒径窄分布与稳定性提升

非球形胶体二氧化硅 CMP 磨料的制备及其在芯片抛光中的作用研究
粒径可控分散度低的溶胶二氧化硅合成及其在蚀刻液与 CMP 磨料中的应用

碳化硅衬底精抛用硅溶胶抛光液的核心技术瓶颈与解决方案

硅溶胶基 CMP 抛光液在先进制程浅沟槽隔离与层间介质中的应用

硅溶胶在氧化物-铜阻挡层抛光中选择比调控与缺陷控制的关键技术

高纯硅溶胶在先进封装再分布层平坦化中的磨料性能优化

阳离子改性酸性硅溶胶在化学机械抛光中的表面化学作用机制

硅溶胶对半导体晶圆抛光后表面微划痕与颗粒残留的成因与控制

大粒径硅溶胶 CMP 磨料的制备及其在碳化硅、氮化镓抛光中的应用

功能化硅溶胶在 3D NAND 闪存多层堆叠结构平坦化中的关键技术

硅溶胶在 Micro-LED 衬底精密抛光中的表界面化学调控

有机-无机杂化改性硅溶胶在蓝宝石衬底抛光中的协同去除机理

硅溶胶在光学玻璃与精密透镜冷加工中的高精度抛光应用

片状金属基材用硅溶胶化学机械抛光液的表面粗糙度控制研究

硅溶胶稳定性表征技术与长期储存性能保障方案

核壳结构 SiO₂@CeO₂复合磨料的制备及其在 CMP 中的协同抛光效应

绿色可循环使用硅溶胶抛光液的配方设计与废液处理技术